



2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社**フェローテックホールディングス**

代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)

問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

**半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による
第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ**

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造の子会社である寧夏富楽徳石英材料有限公司（以下、「AQM-N」）が、将来的に中国の科创板市場への上場を目指すことを前提に、第三者割当増資を行うことを決定しましたので、以下のとおりお知らせします。また、本件によりAQM-N社が当社の特定子会社に該当することになりますのであわせてお知らせします。

記

1. 増資の背景と目的

近年、3D-NANDフラッシュメモリーの需要増加に伴い、そのキー・プロセスであるエッチング工程^(注)は今まで以上に物理的・化学的に負荷がかかるプロセスとなっており、半導体製造装置用の消耗品も交換頻度が多くなっております。一方で、消耗品の交換頻度の増加や微細化の進展により、デバイス特性やプロセス歩留りに影響を与えるコンタミネーション^(注)管理が半導体製造プロセスにおいてこれまで以上に重要になってきており、従来の石英や酸化アルミニウム、酸化イットリウム等を材料としたパーツからシリコンウエーハと熱膨張係数が同一で高純度なシリコン製のパーツ（シリコンパーツ）への切り替え需要が急速に高まっております。さらに、ウエーハの大口径化に伴い、半導体シリコン結晶育成に使用される消耗品である合成石英坩堝の大口径化への需要も高まっております。このような市場環境の中、財務基盤の更なる強化を図りながら、旺盛な顧客需要に応じて機動的に生産能力の増強を行なうことで、一気に顧客の困り込みを図れる千載一遇の機会ととらえ、今回、AQM-Nの中国株式市場への上場を目指すことを前提に、第三者割当増資を行うことを決定しました。なお、上場日等の詳細は現時点では未定であり、中国の当局又は証券取引所による必要な承認を得られない可能性や、今後の準備過程における株式市況ならびに事業環境の変化や資本提携先との協議の結果次第では、上場を行わないという結論に至る可能性もあります。

^(注)<用語説明>

エ ッ チ ン グ	ウエーハ上に回路を描く工程が完了した後に、不要な酸化膜を除去して半導体のパターンを残す工程。液体、ガス、またはプラズマを用いて回路パターンと区別した不要な層を選択的に除去します。
-----------	---

コンタミネーション	半導体デバイスの製造プロセスにおいて発生する不純物、微小なゴミ（有機物、無機イオン、金属元素、粒子）のことを指します。デバイス特性やプロセス歩留りに大きな影響を与えます。
-----------	---

2. 調達資金の用途

主に製造設備への投資資金に充当予定。当該設備投資の詳細については確定しだい改めてお知らせします。

3. 子会社の概要（2021年2月9日現在）

(1) 名 称	寧夏富楽徳石英材料有限公司（略称：AQM-N）		
(2) 所 在 地	中華人民共和国寧夏回族自治区銀川市銀川經濟技術開發区光明西路23号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢		
(4) 事 業 内 容	半導体製造用治具・消耗部材の製造・販売		
(5) 資 本 金	111百万人民币（約17.8億円）※1人民币=16.0円		
(6) 設 立 年 月 日	2011年4月20日		
(7) 大株主及び持分比率	株主名	現状	本件後
	杭州大和熱磁電子有限公司（連結子会社）	89.2%	71.3%
	従業員持株会	10.0%	7.9%
	投資基金（4社計）		20.0%
8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の連結子会社です。	
	人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任。	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	
(9) 最近3ヵ年の単体経営成績及び財政状態（単位未満切り捨て）			
決 算 期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
純 資 産	69,561千人民币 (1,113百万円)	71,470千人民币 (1,143百万円)	73,016千人民币 (1,168百万円)
総 資 産	139,535千人民币 (2,232百万円)	164,065千人民币 (2,625百万円)	191,971千人民币 (3,071百万円)
1株あたり純資産	- (-百万円)	- (-百万円)	- (-百万円)
売 上 高	117,310千人民币 (1,877百万円)	89,623千人民币 (1,434百万円)	81,383千人民币 (1,302百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	1,517千人民币 (24百万円)	1,909千人民币 (30百万円)	1,545千人民币 (25百万円)
1株あたり配当金	- (-百万円)	- (-百万円)	- (-百万円)

(注1) AQM-Nはシリコンパーツ事業を行っている杭州盾源聚芯半導体科技有限公司（略称：FTHS）を子会社に有しておりますが、同社はサブ連結を行っていないため、上記経営成績及び財政状態の数字はAQM-N単体の数字となっております。

(注2) 為替レート：1人民币 = 16.00円

(注3) AQM-Nは有限公司であるため、1株当たりの純資産、同配当金の記載を省略しております。

4. 子会社における第三者割当の概要

(1) 発行価額	資本金1人民元あたり11.7人民元(約187.20円) ※1人民元=16.00円	
(2) 払込出資金総額	325,000千人民元(約52.0億円)	
(4) 払込期日	2021年2月26日	
(5) 増加資本金	27,778千人民元(約4.5億円)	
(6) 増資後資本金	138,889千人民元(約22.2億円)	
(7) 割当先・割当数量	① 厦門建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) ② 嘉兴君帷股权投资合伙企业(有限合伙) ③ 嘉兴临格股权投资合伙企业(有限合伙) ④ 共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	投資家別の割当数量については現在調整中

(注)当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当先の概要 ※出資金額、出資比率は調整中の為、確定次第改めてお知らせします。

	①	②
(1) 社名	厦門建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)	嘉兴君帷股权投资合伙企业(有限合伙)
(2) 資本金	5億人民元(約80億円)	0.46億人民元(約7.4億円)
(3) 設立年月日	2016年6月27日	2020年12月10日
(4) 大株主及び持ち分比率	厦門建发新兴产业股权投资有限责任公司 99.80%	上海君桐股权投资管理有限公司 0.65%、聞一雷 10.0%、王笑 6.5%、王志平 17.4%、国世通控股有限公司 21.8%、福建省芯旺投资合伙企业(有限合伙) 21.8%、上海欣竝科技服务合伙企业(有限合伙) 21.8%
(5) 代表者	蔡晓帆	聞威
(6) 事業内容	非証券株式投資及びアドバイザー業務の受託、産業投資、投資運用、アセットマネジメント	株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。
(8) 出資金額及び出資比率	調整中	調整中

注：為替レート 1人民元=16.0円

	③	④
(1) 社名	嘉兴临格股权投资合伙企业(有限合伙)	共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)
(2) 資本金	0.21億人民元(約3.4億円)	3.15億人民元(約50.4億円)
(3) 設立年月日	2020年11月02日	2020年8月7日
(4) 大株主及び持ち分比率	上海临芯投资管理有限公司 0.9% 上海鸿网供应链股份有限公司 20.9%	共青城紫硅投资合伙企业(有限合伙) 16.0%、李建 8.5%

	王毅 54.8% 酈韩英 23.3%	福州名源食品有限公司 5.3%
(5) 代 表 者	GP：上海臨芯投資管理有限公司 (代表人：宋延延)	GP：共青城芯城股权投资合伙企业 (有限合伙) (代表人：張亮)
(6) 事 業 内 容	株式投資、実業投資	産業投資、株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく 関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、 関連当事者には該当しません。
(8) 出 資 金 額 及 び 出 資 比 率	調整中	調整中

注：為替レート 1人民元=16.0円

6. 異動の日程

(1)	A Q M N 董 事 会 決 議 日	2021年02月10日
(2)	当 社 取 締 役 会 決 議 日	2021年02月10日
(3)	払 込 期 日	2021年02月28日(予定)

7. 今後の見通し

連結業績への影響につきましては現在精査中ですが、必要と判断された場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

<子会社の上場に関する既往開示リリース> これまで子会社4社の上場を計画しております。

事業内容	対象子会社	開示時期	開示題名
石 英 坩 埚 シリコンパーツ	寧夏富楽徳石英材料 有限公司	2021/2/10	「半導体製造用部材(石英坩埚、シリコンパーツ)製造子会社による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ」
パ ワ ー 半 導 体 用 基 板	江蘇富楽徳半導体科技 有限公司	2020/11/17	「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」
半 導 体 ウ ェ ー ハ	杭州中欣晶圓半導体 股份有限公司	2020/09/15	「半導体ウェーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ」
精 密 部 品 再 生 洗 浄	安徽富楽徳科技發展 股份有限公司	2020/08/14	「中国子会社の科创板市場(スター・マーケット)への上場準備に関するお知らせ」

この文書は、当社連結子会社である寧夏富楽徳石英材料有限公司の中国株式市場への将来的な株式上場へ向けた準備に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオフERING・メモランダム又はプロスペクトスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。